

(有)シード精工

シードセイコウ

難形状ワークの試作や、精度の高い開発部品の製作
研磨、放電加工のネットワークで、超精密複合加工



主にマシニングセンターで切削加工をしています。
加工治具や加工方法を工夫して、難形状ワークの試作や、高精度開発部品を製作しています。
高度な技術を持つ研磨、放電などの加工技術ネットワークで、超精密複合加工にも対応しています。
FPD製造装置・半導体製造装置や医療機器(CT診断装置)部品の実績があります。

主要設備

マシニングセンター 3台 NCフライス 1台
2次元3次元CAD,CAM(DXF,IGS,STL)
デジマイクロ(ニコン) 測定顕微鏡(ミットヨ)マイクロメーター各種

得意な加工分野

旋盤・NC旋盤加工 | フライス・M/C加工 | プレス・板金加工 | 研削加工 | 研磨加工 | 溶接加工
樹脂成形加工 | ゴム成形加工 | 放電加工(ワイヤー・形彫) | ばね・ワイヤーフォーミング加工
ガラス・レンズ加工 | セラミックス加工 | 熱処理 | めっき・蒸着・表面処理 | 塗装 | 金型製作
MIM(金属粉末射出成型) | 3Dプリンター(積層造形法) | 鋳造・ダイカストロストワックス
鍛造 | 各種試作開発 | その他加工

所在地：〒144-0033
大田区東糀谷
6-4-17-407

T E L : 03-5735-1855
F A X : 03-5735-1856
E-mail : katayama@seedsk.jp
U R L : <http://seedsk.jp/>

部署名：代表取締役
担当者：片山 幸博